

性能特点：

- 频率范围：4GHz-8GHz
- 转换增益：-14dB
- F0 隔离度：45dBc
- 3F0 隔离度：45dBc
- 4F0 隔离度：35dBc
- 输入信号功率：15dBm
- 芯片尺寸：1.5mm×0.69mm×0.1mm

产品简介：

HH-MP204 是一种 GaAs MMIC 无源倍频器，此款倍频器芯片在输入功率为 15dBm 时，转换增益典型值为 -14dB，对基波抑制制度达到 45dBc，对三次谐波抑制制度达到 45dBc，对四次谐波抑制制度达到 35dBc，典型输入功率为 15dBm。

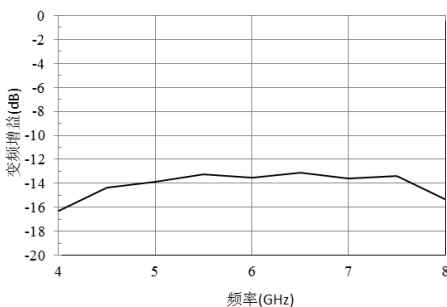
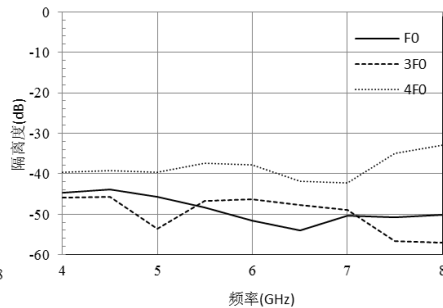
电参数： ($T_A=25^{\circ}\text{C}$, $P_{in}=15\text{dBm}$)

指标	最小值	典型值	最大值	单位
输入频率	4-8			GHz
输出频率	8-16			GHz
转换增益	-13	-14	-16	dB
基波抑制制度	45	-	-	dBc
三次谐波抑制制度	45	-	-	dBc
四次谐波抑制制度	35	-	-	dBc

使用限制参数：

最大输入功率	27 dBm
存储温度	-65°C-150°C
使用温度	-55°C-125°C

典型曲线：

 转换增益曲线@ $P_{in}=15\text{dBm}$

 隔离度@ $P_{in}=15\text{dBm}$


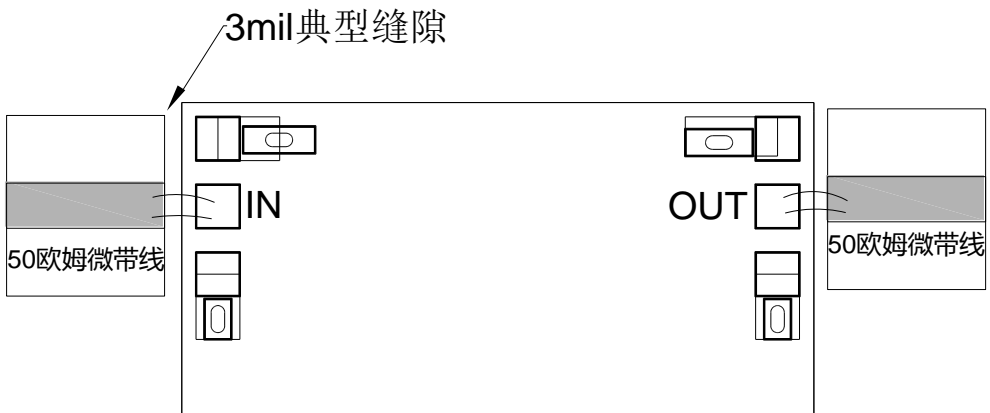
尺寸图：(单位 mm)



06

倍
频
器

建议装配图：



使用说明：

注意事项：输入输出有隔直电容

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。